

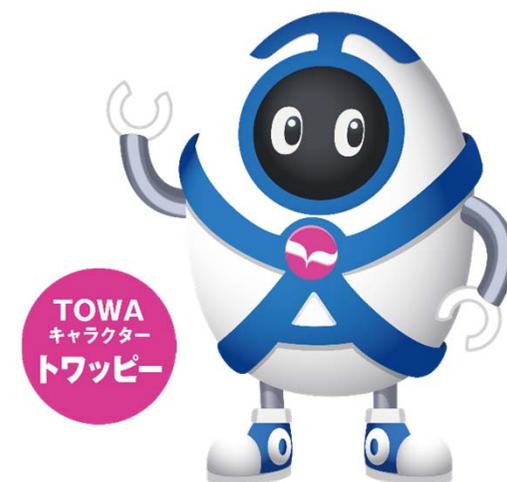


2025年3月期

第2四半期決算説明資料

2024年11月7日

[Click here for the English Ver](#)



TOWA株式会社

主な説明内容

- 1. 2025年3月期 上期実績**
- 2. 2025年3月期 通期予想**
- 3. TOPICS**

主な説明内容

- 1. 2025年3月期 上期実績**
2. 2025年3月期 通期予想
3. TOPICS

2025年3月期 上期サマリー

受注高
252.4億円

売上高
273.9億円

営業利益
52.6億円

経常利益
52.2億円

当期純利益
38.2億円

▶ 受注高

- ・ 中国での半導体内製化に向けた投資が好調。
- ・ 先端パッケージや通信デバイス関連向けでコンプレッション装置および金型の受注高は半期で過去最高。

▶ 売上高

- ・ 受注同様に中国、その他アジアが堅調。
- ・ 顧客稼働率改善により、TSS（トータル・ソリューション・サービス）売上が好調。

▶ 利益

- ・ 売上高の増加や製品ミックスの改善により、各段階利益ともに前年同期比で大幅増益。

2025年3月期 上期連結業績結果

(単位：億円)

	2024/3期 上期実績	2025/3期 上期実績	前年比	2025/3期 上期予想	予想比
売上高	212.6	273.9	+ 61.3 (+ 28.8%)	287.0	▲ 13.0 (▲ 4.5%)
営業利益	23.8	52.6	+ 28.7 (2.2倍)	56.5	▲ 3.8 (▲ 6.9%)
営業利益率	11.2%	19.2%	+ 8.0pt	19.7%	▲ 0.5pt
経常利益	27.6	52.2	+ 24.6 (1.9倍)	56.5	▲ 4.2 (▲ 7.4%)
当期純利益	19.5	38.2	+ 18.6 (2.0倍)	39.6	▲ 1.3 (▲ 3.4%)

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

2025年3月期 上期セグメント別売上高

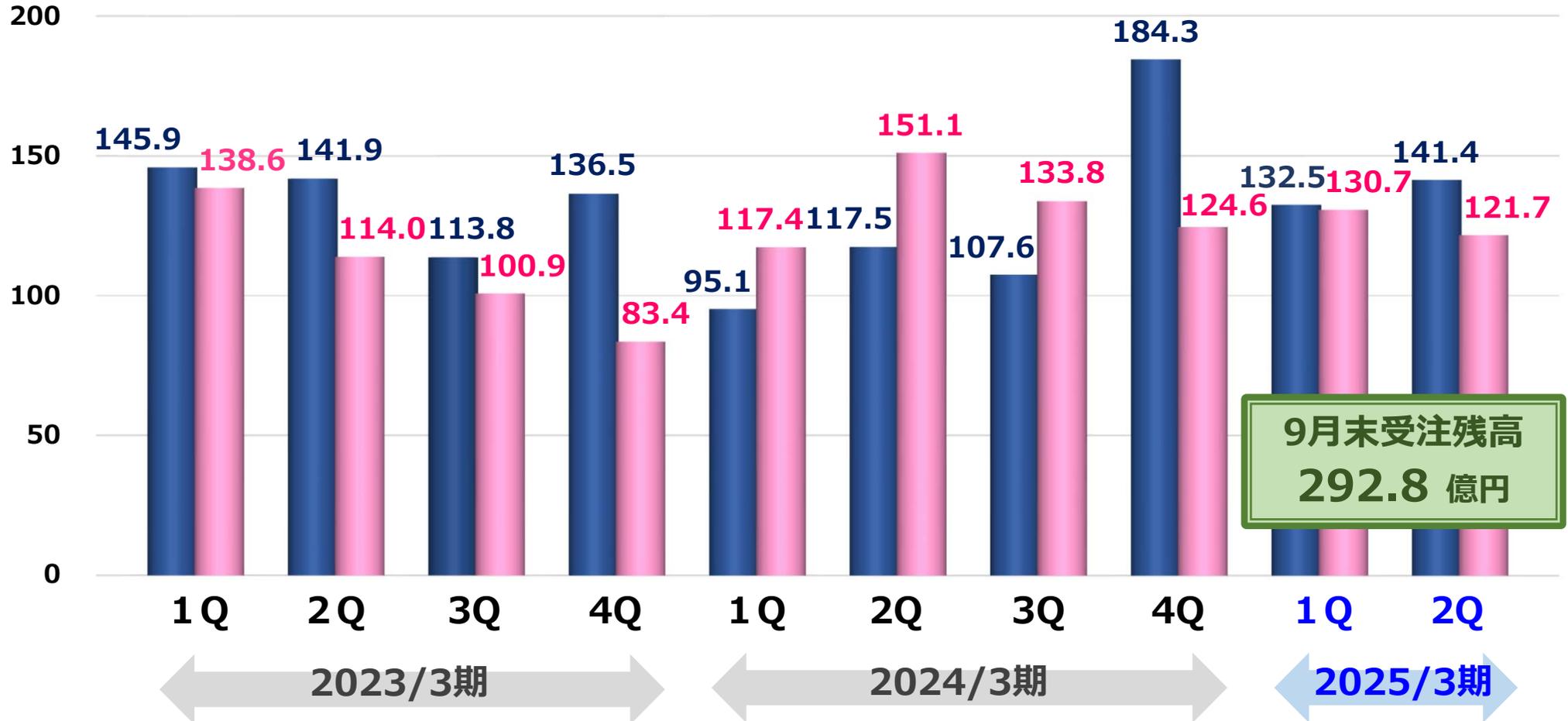
(単位：億円)

	2024/3期 上期実績	2025/3期 上期実績	前年比	2025/3期 上期予想	予想比
売上高	212.6	273.9	+ 61.3 (+ 28.8%)	287.0	▲ 13.0 (▲ 4.5%)
半導体事業	157.5	207.4	+ 49.9 (+ 31.7%)	213.0	▲ 5.5 (▲ 2.6%)
化成品事業	10.9	11.3	+ 0.3 (+ 3.1%)	11.0	+ 0.2 (+ 2.6%)
新事業	32.4	45.7	+ 13.3 (+ 41.1%)	50.0	▲ 4.3 (▲ 8.6%)
レーザ事業	11.8	9.5	▲ 2.2 (▲ 19.1%)	13.0	▲ 3.4 (▲ 26.6%)

受注・売上高の推移

(単位：億円)

■ 売上高 ■ 受注高

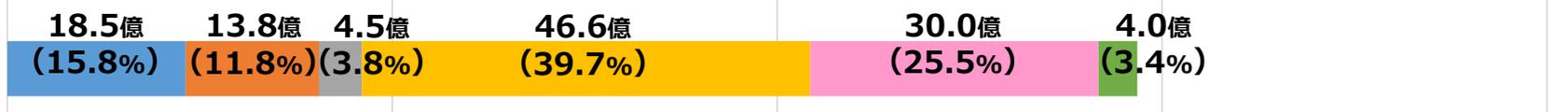


地域別受注構成比率推移（仕向地ベース）

(単位：億円)

0 40 80 120 160

2024/3期
(1Q)



(2Q)



(3Q)



(4Q)



2025/3期
(1Q)



(2Q)



日本 台湾 韓国

中国

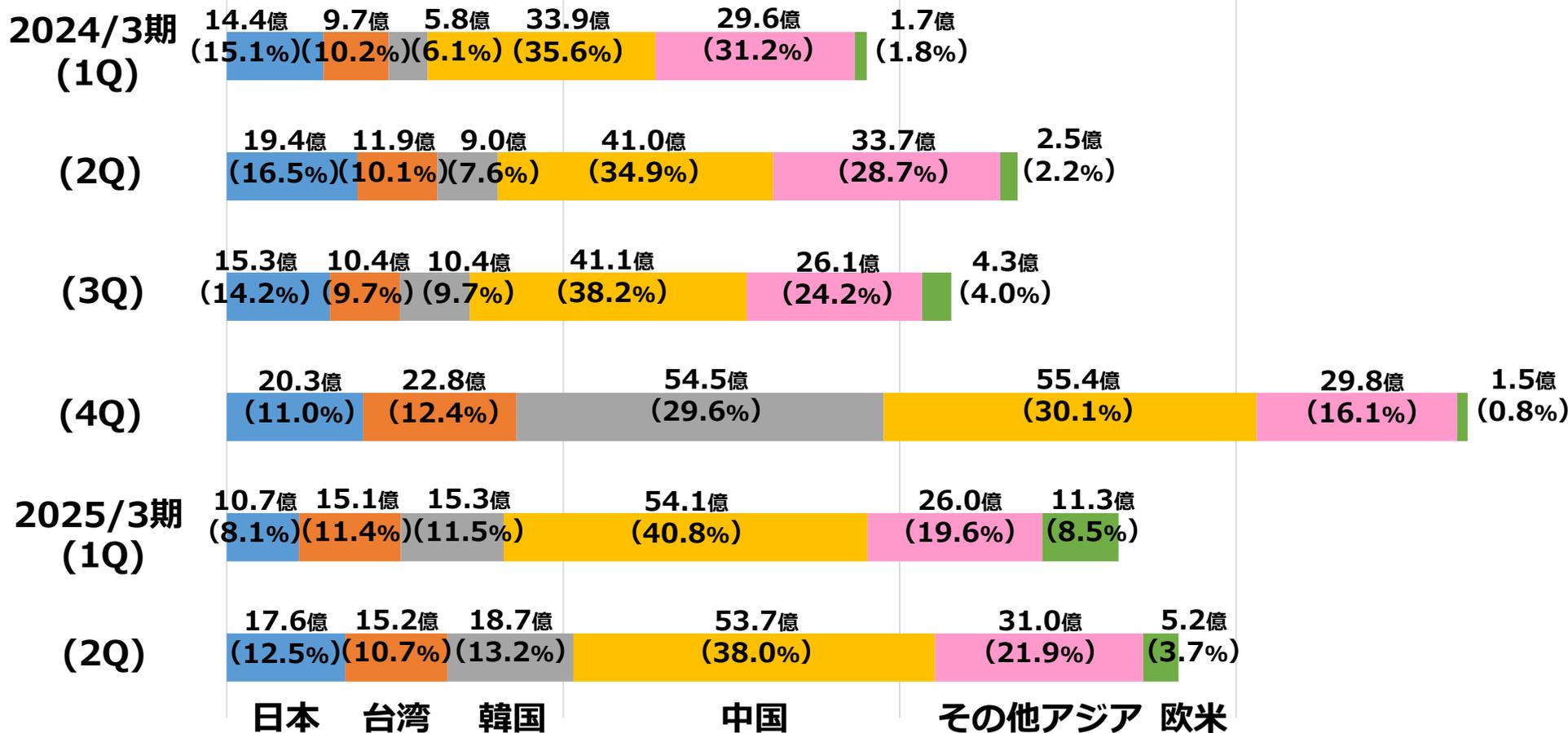
その他アジア

欧米

地域別売上構成比率推移（仕向地ベース）

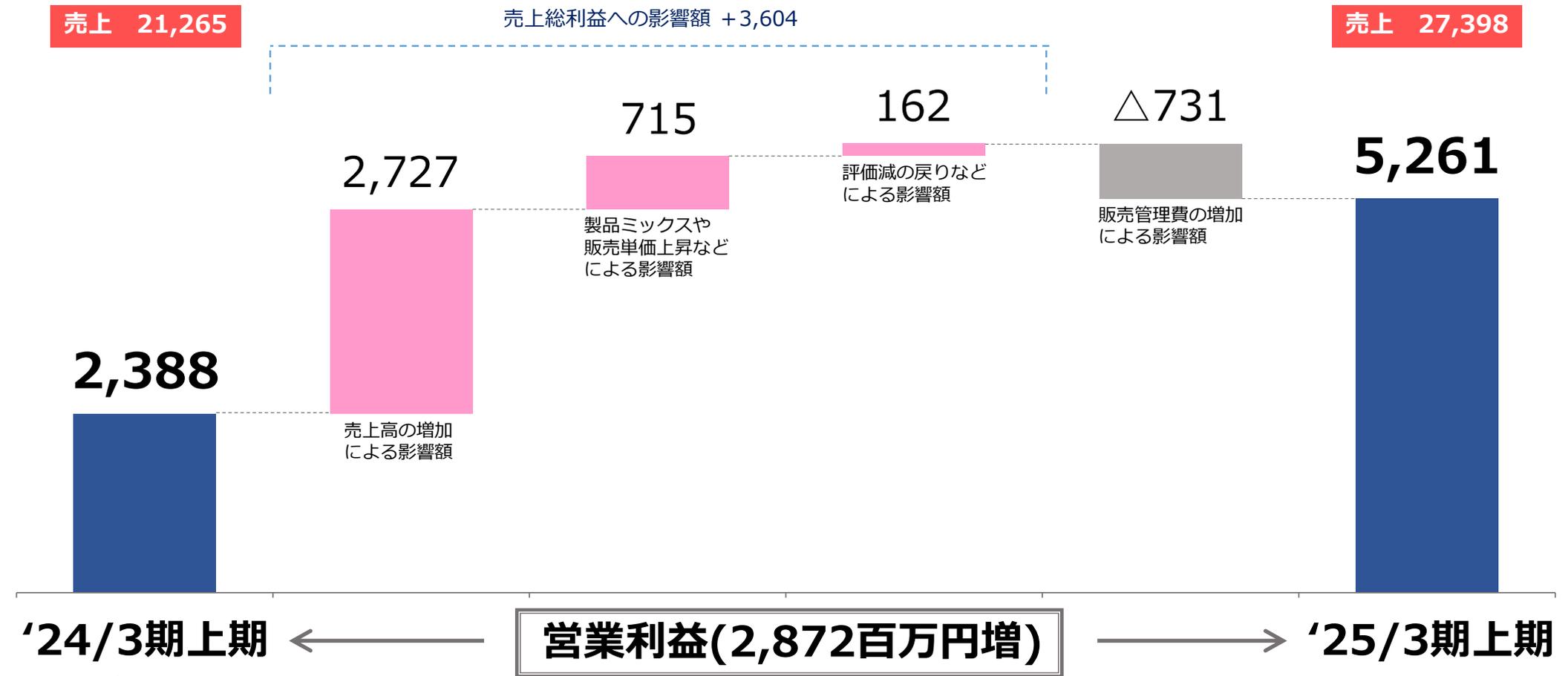
(単位：億円)

0 50 100 150 200



2025年3月期上期 連結営業利益 増減要因分析

(単位：百万円)



※百万円未満切り捨て

主な説明内容

1. 2025年3月期 上期実績
2. 2025年3月期 通期予想
3. TOPICS

2025年3月期 通期 連結業績予想

※期初予想から変更なし

(単位：億円)

	24/3期 通期実績	25/3期		増減額	前期比	
		上期実績	下期予想			通期予想
売上高	504.7	273.9	326.1	600.0	+ 95.2	+ 18.9%
営業利益	86.6	52.6	73.4	126.0	+ 39.3	+ 45.5%
営業利益率	17.2%	19.2%	22.5%	21.0%	-	+ 3.8pt
経常利益	90.7	52.2	73.8	126.0	+ 35.2	+ 38.8%
当期純利益	64.4	38.2	50.1	88.3	+ 23.8	+ 37.0%

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

2025年3月期 セグメント別売上予想

※期初予想から変更あり

(単位：億円)

	24/3期 通期実績	25/3期			増減額	前期比
		上期実績	下期予想	通期予想		
売上高	504.7	273.9	326.1	600.0	+ 95.2	+ 18.9%
半導体事業	383.2	207.4	246.6	454.0	+ 70.8	+ 18.5%
化成品事業	21.5	11.3	11.0	22.3	+ 0.8	+ 3.7%
新事業	75.8	45.7	50.4	96.1	+ 20.3	+ 26.8%
レーザ事業	24.2	9.5	18.0	27.6	+ 3.4	+ 14.0%

今後の市場見通し

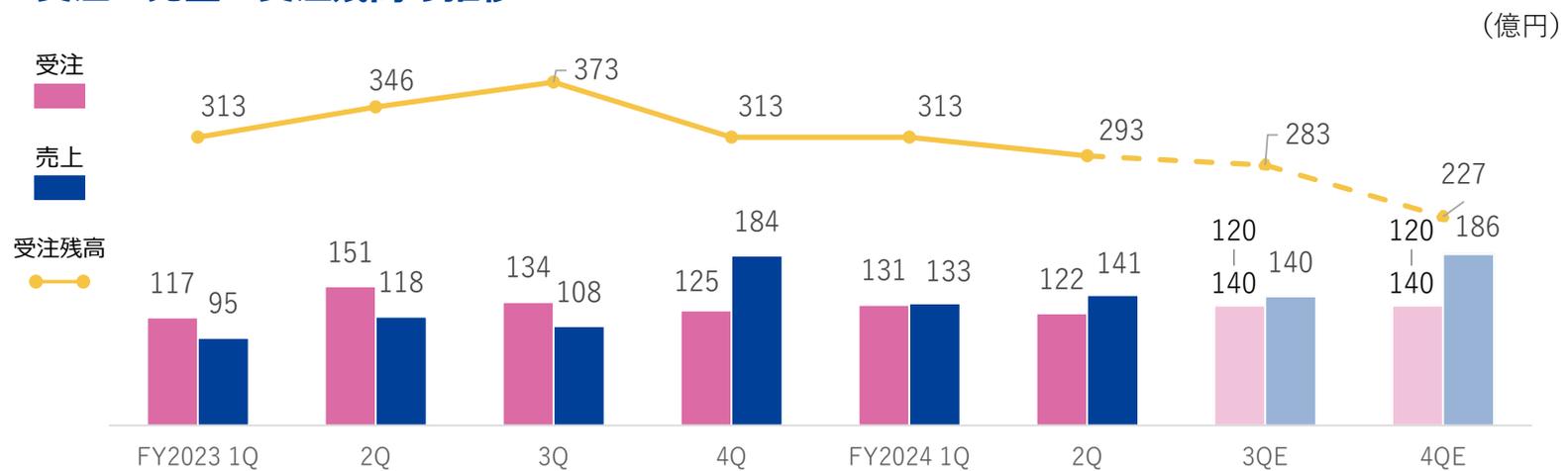
今後の市場見通し

- 受注高の見通しを修正。下期から見込んでいた民生品やメモリ関連の需要回復は後ろ倒しになっており、本格的な回復は来期以降を予想。
- 売上高については、2Q末時点の受注残高（293億円）及び下期の受注予定から通期予想は据え置き。なお、顧客納期の関係などから売上は4Qに集中する予定。
- 生成AI関連などの先端パッケージ向けは下期も堅調に推移する見込み。

損益予想 (変更なし)

売上高	600億円
営業利益	126億円
経常利益	126億円
当期利益	88.3億円

受注・売上・受注残高の推移



2025年3月期 配当計画

	2024/3期 実績	2025/3期 計画
配当	13.3円 (40.0円)	20.0円 (60.0円)

※当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
2024年3月期は株式分割されていたと仮定した金額を記載しています。
また、株式分割が行われる以前の金額を（ ）内で記載しています。
なお、中間配当は見送りとさせていただきます。

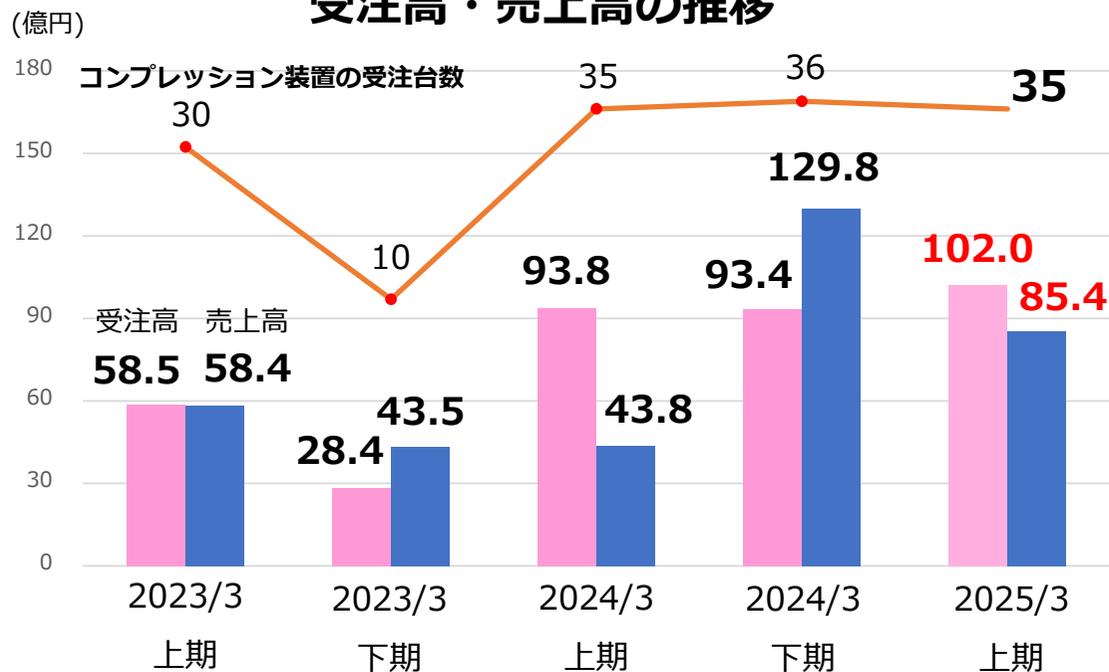
主な説明内容

1. 2025年3月期 上期実績
2. 2025年3月期 通期予想
- 3. TOPICS**

TOWA独自のコンプレッション装置

コンプレッション装置の受注・売上高は好調を維持！

コンプレッション装置※
受注高・売上高の推移



※装置・金型含む

独自のコンプレッション技術

- 薄型、積層、モジュール化されたパッケージに最適
- 独自技術により、狭ギャップ成形が可能
- 大判化されたパッケージにも対応可能

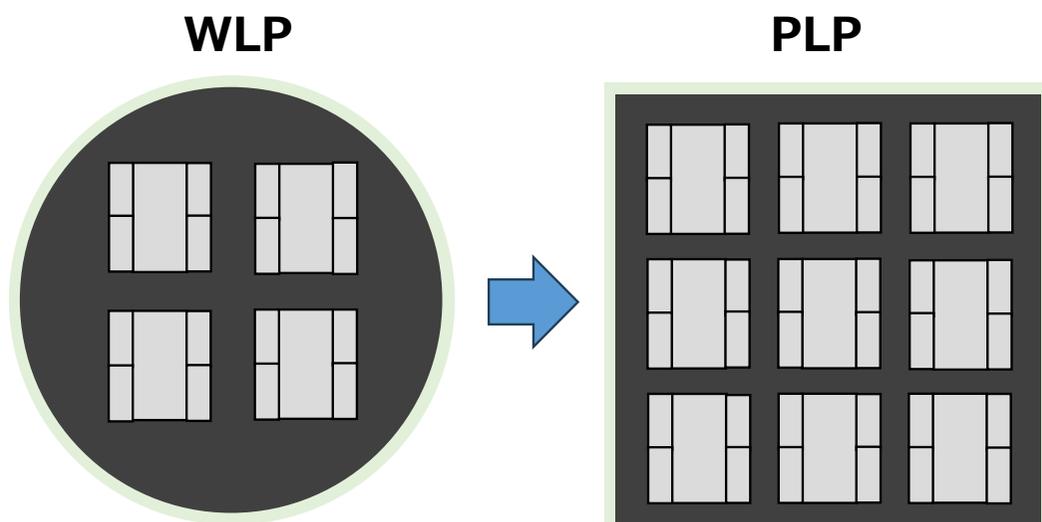
コンプレッション技術の活用が期待される分野

用途	技術
生成AI	ウェハーレベルパッケージ
次世代スマホ	パネルレベルパッケージ
自動運転	2.5D、3Dパッケージ
IoT	

PLP (Panel Level Package)

PLP向け装置の引合・受注が増加

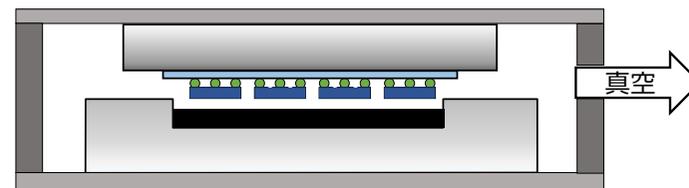
- 生産効率向上を目的に、WLPからPLPへ製造プロセスが移行
⇒ **コンプレッション装置の優位性はより高まる！**



**1回で成形できる製品数が増加し、
生産効率が大幅に改善！**

PLPに対するコンプレッション装置の優位性

**TOWA独自のキャビティダウン構造により、
パネルの四隅にまで樹脂を隙間なく
充填！**



PLP向けコンプレッション装置
Model: CPM1180
Work max size : 660x620mm

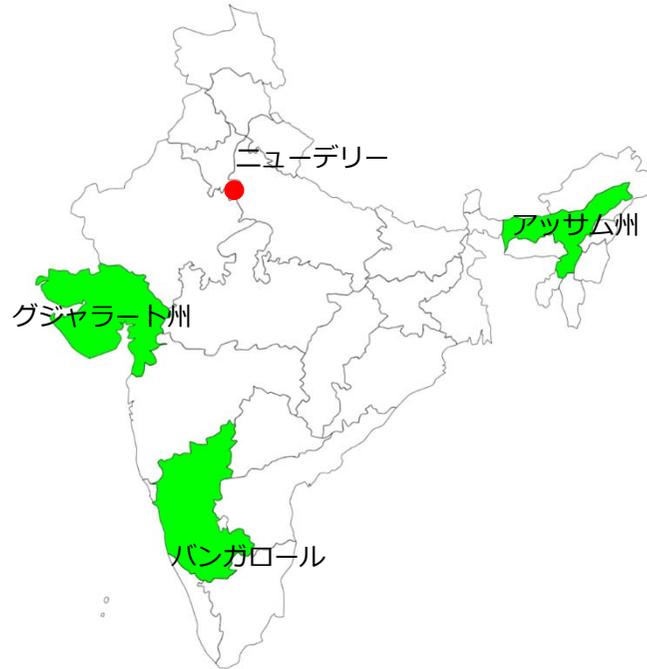
インドでのビジネス強化

インドにおける事業強化に向け、販売子会社設立を決定

▶ インドでは政府支援のもと半導体産業育成に注力しており、すでに地場の大手財閥や大手半導体メーカーが投資計画を決定。

⇒ 直接現地で営業活動を展開し、立上げ期よりお客様と強固な関係を築く。

インド半導体市場予測



● 本店所在地

● 今後の営業所設置候補地

会社概要

社名	TOWA India Company Limited. (仮)
所在地	インド共和国 ハリヤナ州 グルガオン (予定)
事業内容	半導体製造装置・金型の販売およびアフターサービス
資本金	25,000千インドルピー (約42,750千円)
設立時期	2025年3月までを目途に設立予定

その他トピックス

株式分割を実施

2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しました。

投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。



「JPX日経インデックス400」構成銘柄選定

JPX総研及び日本経済新聞社が共同で算出する「JPX日経インデックス400」の2024年度（2024年8月30日～2025年8月28日）の構成銘柄として選定されました。構成銘柄の選定は、時価総額によるスクリーニングに加え、3年平均ROEなどの定量的な指標による評価、独立社外取締役の選任などの定性的な指標による評価をもとにおこなわれ、400銘柄が選定されています。



JPX-NIKKEI 400

「TOWA統合報告書 2024」発行（日・英）

当社は、財務・非財務情報を統合的に発信するために、マテリアリティの情報も盛り込んだ統合報告書「TOWA統合報告書 2024」を発行いたしました。当社HP上で公開していますので、ぜひご覧ください。

<ご参考> 【TOWA統合報告書 2024】

<https://www.towajapan.co.jp/jp/ir/corporatereport/>

「えるぼし」認定

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良な企業として、厚生労働省より「えるぼし」認定を受けました。当社は今後も両立支援を推進し、女性を含むすべての従業員が能力を最大限発揮し、笑顔で働くことのできる職場づくりに継続して取り組んでまいります。



T O W A ビ ジ ョ ン 2 0 3 2

「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。

参考資料



会社概要

会社名	TOWA株式会社
事業内容	半導体・LED製造装置、超精密金型、 ファインプラスチック成形品、レーザ加工装置
設立	1979年4月
代表者	代表取締役社長 岡田 博和
従業員数	2,056名(連結) [2024年9月末]
資本金	89億円
証券コード	6315
所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地

事業内容

新事業

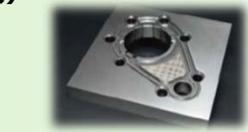
- ・ TSS (トータルソリューションサービス)
- ・ 精密加工用工具、受託加工
- ・ 微細加工
- ・ コーティング



改造・修理
予防保全



微細加工技術



受託加工



工具 (エンドミル)

レーザー加工装置事業

- ・ レーザトリマ
- ・ ウェハーマーカ
- ・ レーザ溶接機



レーザートリミング装置
SL432R



ウェハーマーキング装置
SL473GS3

半導体事業

- ・ 半導体製造用精密金型
- ・ 半導体製造用モールド装置
- ・ 半導体製造用シンギュレーション装置



トランスファー金型



モールド装置
Model PMC2030-D



モールド装置
Model CPM1080

化成品事業

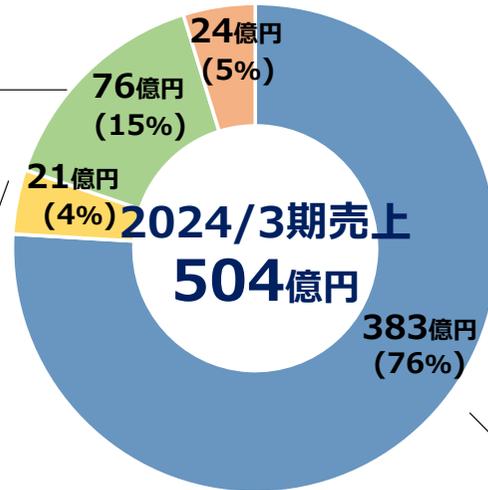
- ・ ファインプラスチック成形品
- ・ 医療機器



点滴用部品



注射器用部品



生産拠点

● TOWA ● グループ会社



韓国

- TOWA韓国株式会社 半導体製造装置、精密金型、部品の製造
- TOWAファイン株式会社 ブレードの製造



中国

- TOWA半導体設備（蘇州）有限公司 半導体製造装置、精密金型の製造



- 東和半導体設備（南通）有限公司 半導体製造装置、精密金型の製造



マレーシア

- TOWAM Sdn. Bhd. 半導体製造装置の製造
- TOWA TOOL Sdn. Bhd. 半導体製造用金型の製造



京都

- 本社・工場（京都市）

半導体製造装置、精密金型の開発・製造



日本

京都

- 京都東事業所（宇治田原町）

半導体製造用金型の製造



佐賀県（鳥栖市）

- 九州事業所

半導体製造用金型の製造



山梨県（韮崎市）

- 株式会社バンディック

ファインプラスチック成形品の製造



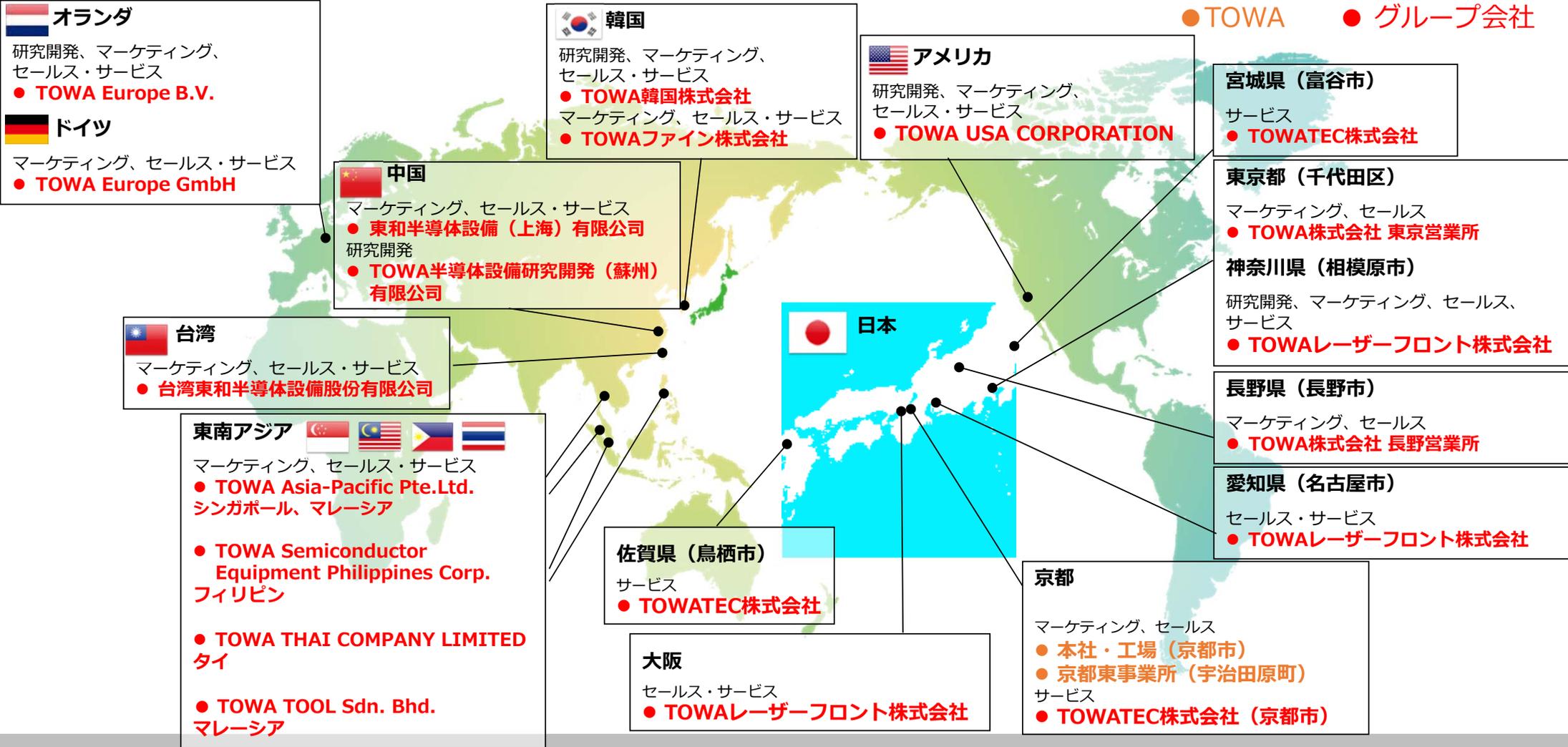
神奈川県（相模原市）

- TOWAレーザーフロント株式会社

レーザ及びびレーザ加工装置の開発、製造

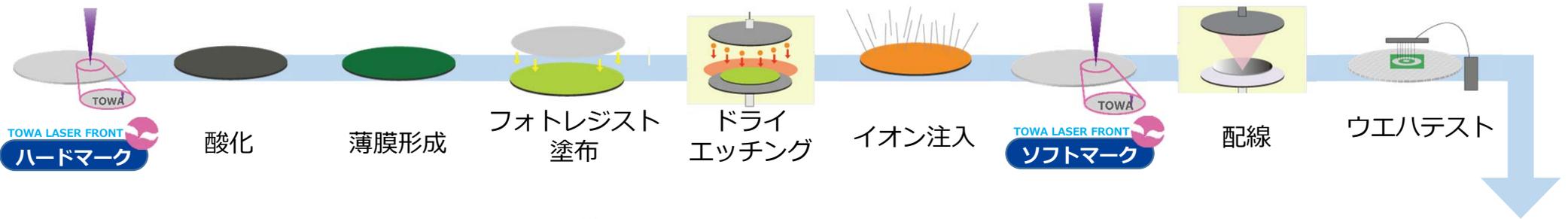
販売・サービス拠点

● TOWA ● グループ会社



半導体が出来るまで

前工程



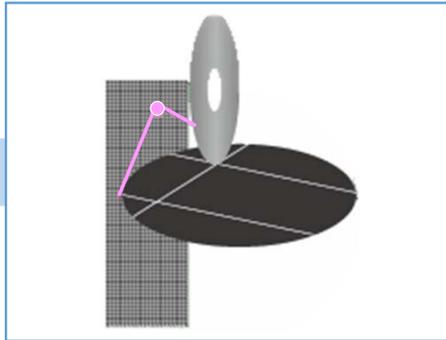
製品検査や
信頼性試験を
経て・・・

**半導体
完成！**



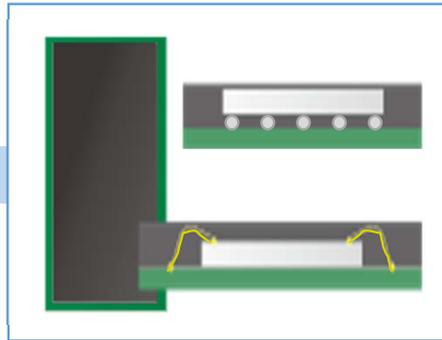
TOWA

シンギュレーション



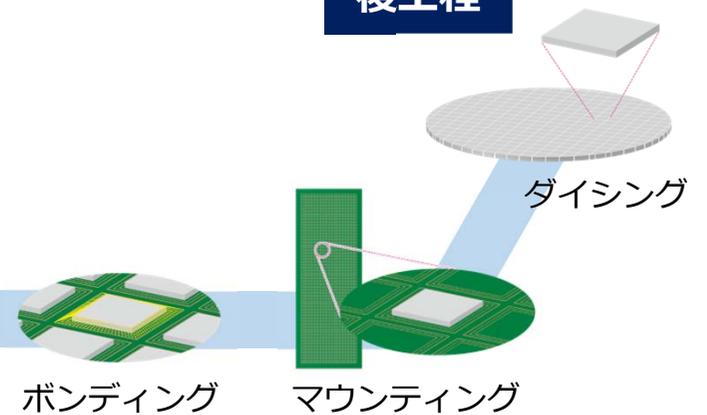
フレームから個々の製品を
切り離します。

モールドイング



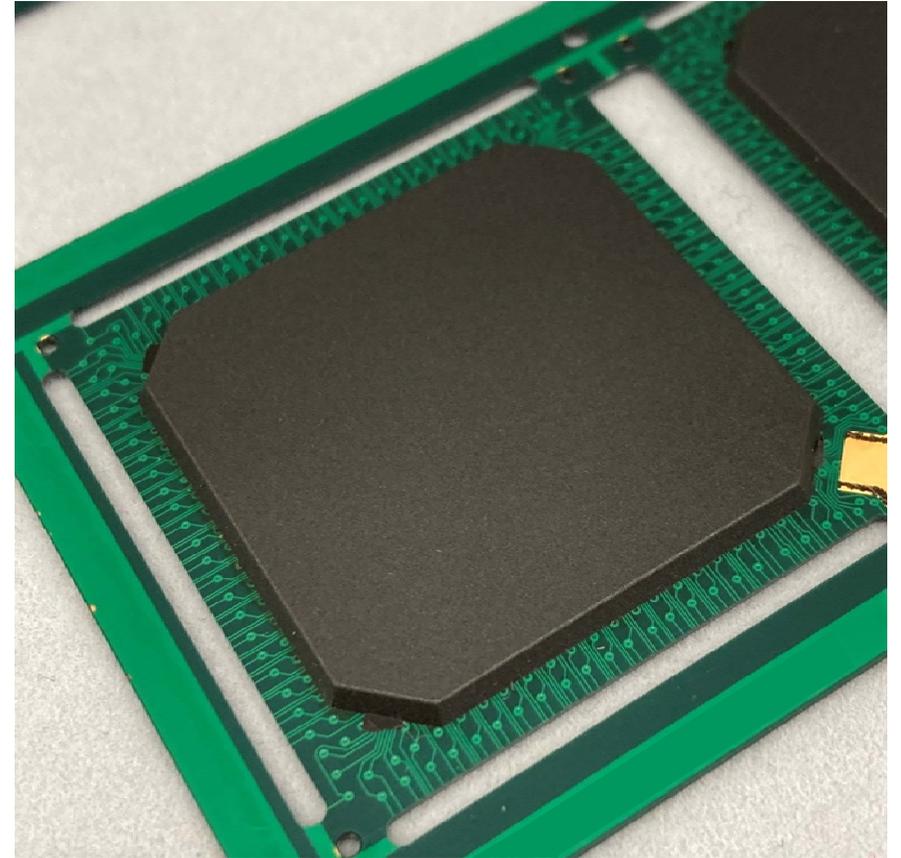
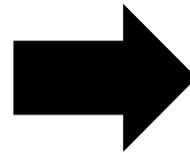
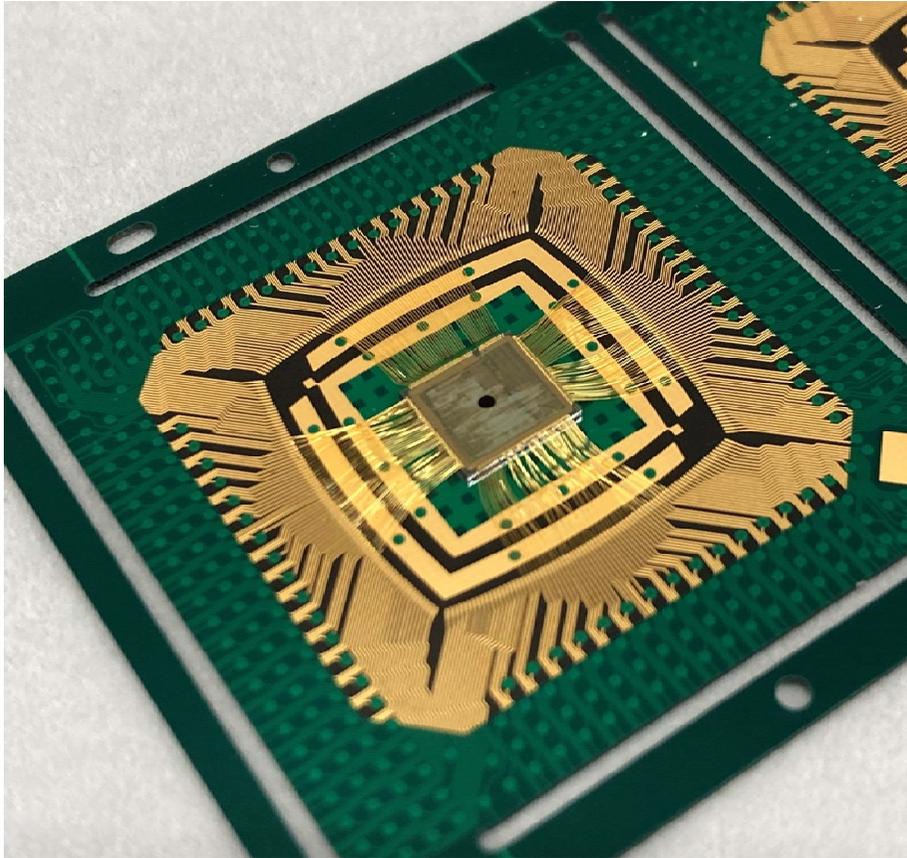
チップを樹脂で封止します。

後工程



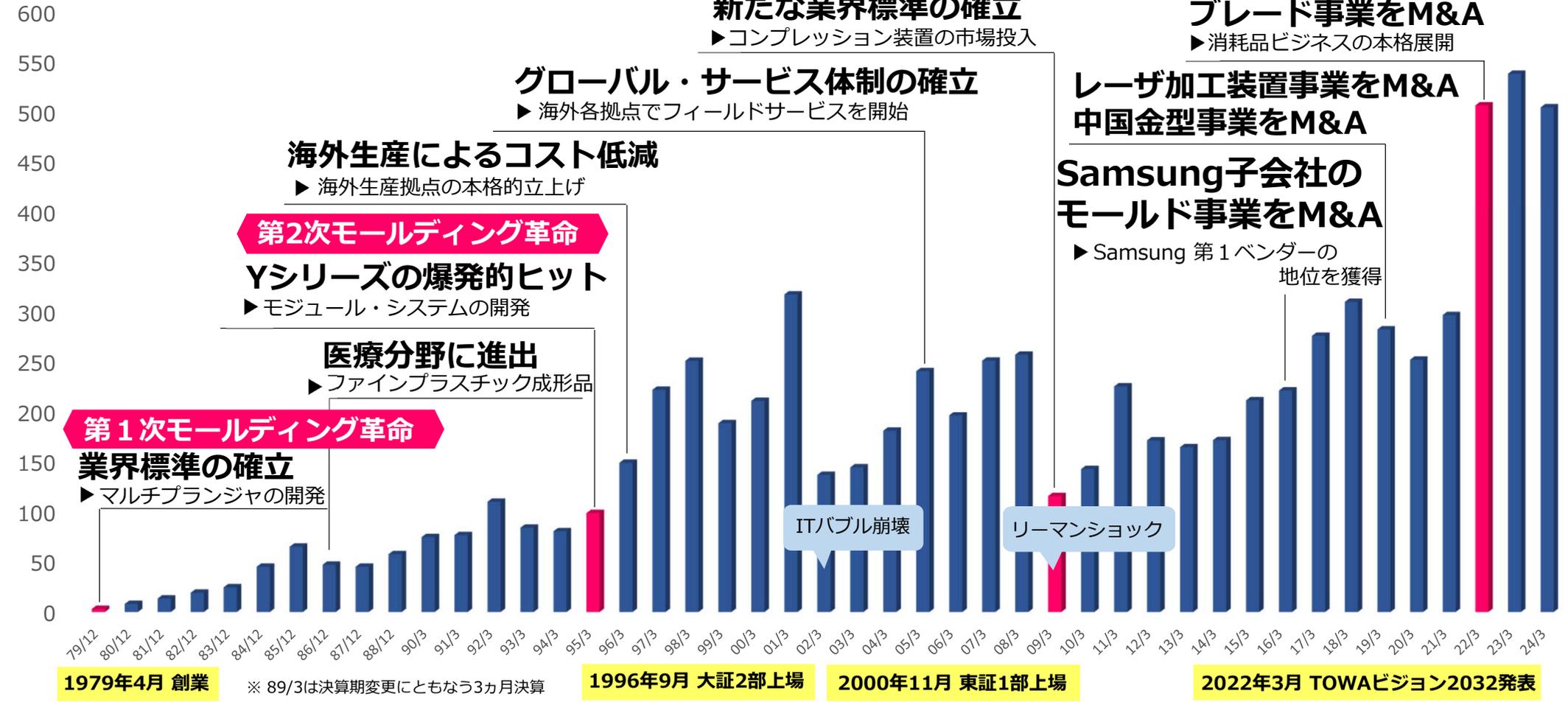
半導体樹脂封止（モールドディング）

半導体チップやワイヤーを樹脂で包み保護する



TOWAの歩み

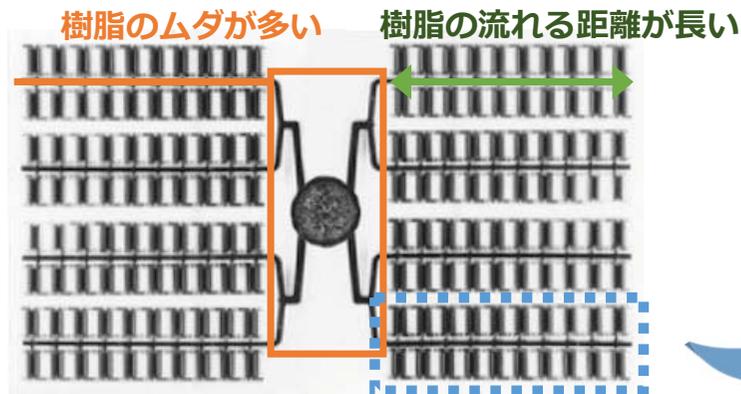
(億円)



第1次モールドディング革命(1979年)

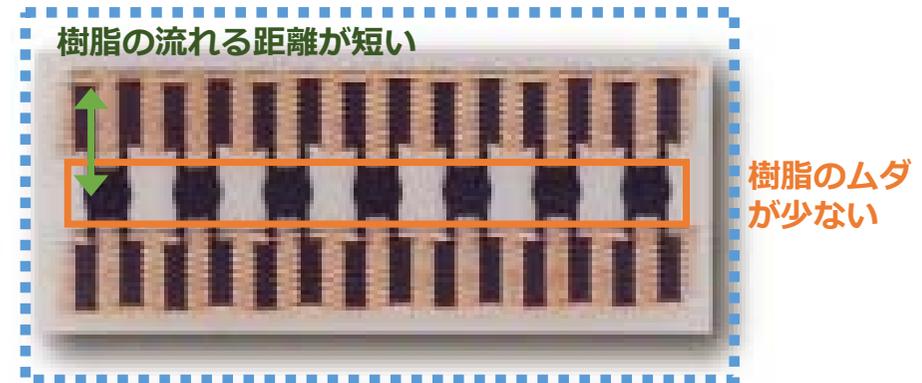
コンベンショナルモールド

手のひらサイズの樹脂を一カ所から注入し、**手動**で成形。樹脂の流れる**距離が長く**成形品質に**バラツキ**が出来、**樹脂のムダが多い**。



マルチプランジャモールド

指先サイズの樹脂を複数カ所から注入し、**自動**で成形。樹脂の流れる**距離が短く**成形品質が**向上**し、**樹脂のムダが少ない**。



第2次モールドディング革命(1995年)

モジュールシステム (Yシリーズ)

モジュールシステム以前のモールドディング装置は・・・

- ・ 一品一様であり、生産する**製品毎に装置を買い替え**
- ・ 生産量に応じて**複数の装置を保有**する必要がある



モジュールシステムにより**プレス**の増減が可能に!!

- ・ Yシリーズだけで**様々な製品の生産が可能**
- ・ 生産量に応じて**追加で設備投資が可能**

後工程をIDMから組立専門企業が請け負う時代のニーズに合致!!

世界に誇る半導体モールドディング装置のベストセラー



第3次モールドディング革命(2009年)

コンプレッション装置

TOWA独自のコンプレッション（圧縮）成形方式により、最先端製品の封止と大幅なコスト削減が可能に!!

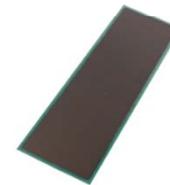
特許や技術的難易度の高さから2009年のリリース以来、現在まで他社の追隨なし。

特 徴

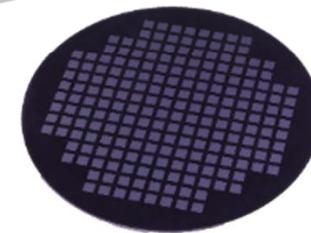
- ・樹脂使用効率**100%**（CO2排出量約**70%**削減）
- ・樹脂流動のない圧縮成形（不良品が**少ない**）
- ・メモリや5G向けなどの**最先端製品**に最適
- ・顆粒/液状樹脂の両方に対応
- ・パネルサイズ、ウェハーサイズに対応



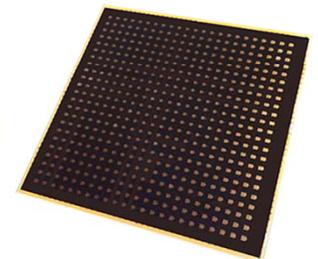
コンプレッション装置
Model PMC2030-D



基板サイズ
100×300mm



ウェハーサイズ
φ300mm



パネルサイズ
600mm×600mm

半導体パッケージへのソリューション

トランスファー成形

注入方式

樹脂流動
有

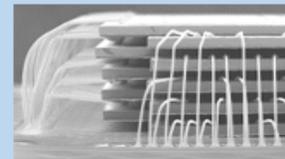
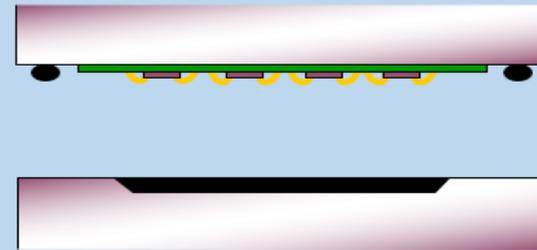


- ・未充填
- ・ワイヤダメージ発生

コンプレッション成形

圧縮方式

樹脂流動
無



- ・大判成形を実現
- ・製品へのダメージなし

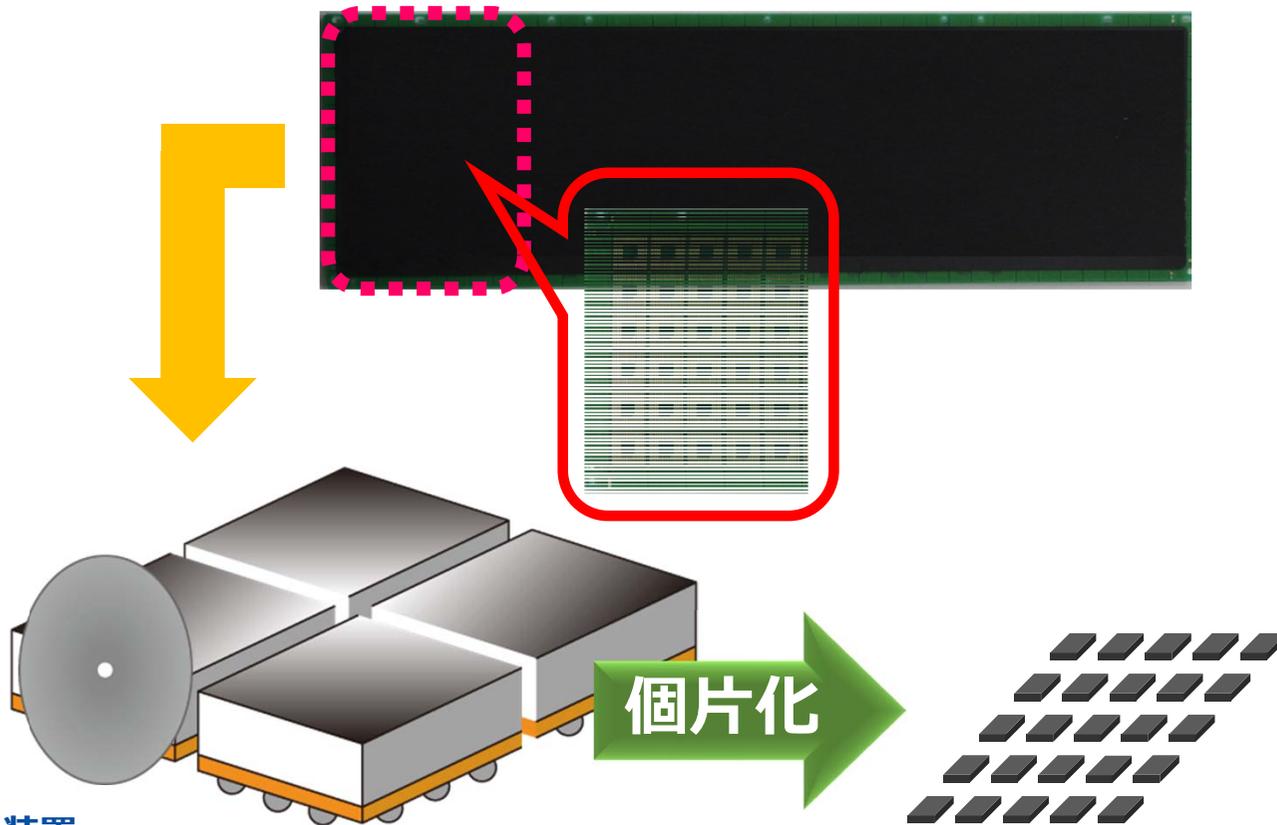
シンギュレーションプロセス

モールドディング後、1つ1つの半導体に個片化する

業界最小！
1.0×1.0mmの
個片化が可能



シンギュレーション装置
Model FMS 4040



半導体製造装置ラインナップ

～ Compression Mold ～

コンプレッション装置
Model CPM 1180



Work max size : 660x620mm

コンプレッション装置
Model CPM 1080



Work max size : φ300mm、320x320mm

コンプレッション装置
Model PMC 2030-D



Work max size : 100x300mm

～ Transfer Mold ～

トランスファ装置
Model YPM 1180



Work max size : 100x300mm

～ Singulation ～

シンギュレーション装置
Model FMS 4040



Work max size : 100x300mm